

Manz 集團接獲半導體產業新客戶訂單,扇外型面板級封裝生產技術開啟加速模式

客戶為全球半導體領導製造商之一，約兩千萬美元的訂單將影響 2022 年和 2023 年的收入及利潤 | 掌握關鍵成長趨勢，發展半導體先進封裝技術，在 AI、車用、5G 三箭齊發下，符合客戶需求提供組成結構更靈活且具成本優勢的解決方案

活躍於全球並具有廣泛技術組合的高科技設備製造商 Manz 集團，掌握半導體關鍵成長趨勢，不斷持續地開發半導體扇外型面板級封裝生產技術，以創新設備以及整合解決方案備受客戶關注。近日接獲全球半導體領導製造商之一的大宗訂單，價值約兩千萬美元，此訂單將影響 2022 年和 2023 年的收入及利潤。

新客戶將採用創新的扇外型面板級封裝 (FOPLP) 技術生產晶片，其關鍵核心技術 RDL (Redistribution Layer, 微細銅重佈線層) 可有效提高 I/O 腳位元數，還讓產品在外型上減少體積、厚度、重量，同時降低製造成本。除此之外，還可以將各種不同功能的晶片也透過 RDL 連結，整合在單一封裝體中，使晶片功能更加強大。在過去幾年中，Manz 所掌握的關鍵核心技術已得到多家客戶的驗證，因此，在這個成長型的市場中已建立了地位。目前也是全球唯一的面板級封裝 RDL 整廠生產設備供應商。

Manz 集團首席執行官 Martin Drasch 說道：「各產業所需的晶片數量正在急劇增加，尤其是在電動汽車和自動駕駛的大趨勢帶動下持續加劇。另一方面，在數位轉型下，數位化應用日益增長，行動載具小型化成為基本的先決條件——也就是說，元件性能提高同時必須也達到體積縮減及成本顯著降低。我們在扇外型面板級封裝的全面專業知識，不論在設備及制程解決方案，皆發揮著至關重要的作用，顯著降低晶片封裝的體積、厚度、重量和製造成本——讓我們的客戶從中受益。」